

2017 年度 学生・教官達成課題(C1)

問題は選択記号形式とする(記号はカタカナのアイウエオカキク…を使用)

【設問】【解答群】【解答】【解説】の4つを必ず記載すること。

用紙が足りない場合は別途用紙を追加しても良い。(※全用紙にクラス記号氏名を明記しホッチキス止め)

実施科目記号	CS11	科目担当	田中信也 先生				
【設問】 SiP(System In Package)の説明として、適切なものはどれか。 【解答群】 ア CPU, チップセット, ビデオチップ, メモリなどコンピュータを構成するための電子回路基板 イ CPU, メモリ, 周辺装置などの間で発生するデータの受渡しを管理する一連の回路群を搭載した半導体チップ ウ 必要とされるすべての機能(システム)を同一プロセスで集積した半導体チップ エ プロセスが異なる機能は、個別に最適化されたプロセスで製造し、パッケージ上でそれぞれのチップを適切に配線した半導体チップ 【解答】 エ 【解説】 ア マイクロコントローラの説明です。 イ チップセットの説明です。 ウ SoC(System on a Chip)の説明です。 エ SiP(System In Package)の説明です。							
クラス記号	IT-11A-723	出席No.	36	学籍No.	70120	氏名	細見 祐